

Inhalt

	Seite
Vorwort.....	2
Einleitung	5
1 Anwendungsbereich	6
2 Normative Verweisungen	6
3 Begriffe	7
4 Allgemeines	8
4.1 Temperaturklassen.....	8
4.2 Schutzniveau	8
4.3 Schutzniveau „maD“	8
4.4 Schutzniveau „mbD“	9
4.5 Versorgungsbedingungen	9
5 Anforderungen an Vergussmassen.....	9
5.1 Allgemeines	9
5.2 Materialangaben	9
6 Temperaturen	10
6.1 Allgemeines	10
6.2 Temperaturbegrenzung	10
6.3 Bestimmung der Grenztemperatur	10
7 Baubestimmungen.....	11
7.1 Allgemeines	11
7.2 Fehlerermittlung.....	11
7.3 Schaltkontakte	18
7.4 Äußere Anschlüsse	18
7.5 Schutz von blanken, spannungsführenden Teilen	18
7.6 Zellen und Batterien	18
7.7 Schutzeinrichtungen	20
8 Typprüfungen	22
8.1 Prüfungen an der Vergussmasse – Prüfung der Wasseraufnahme.....	22
8.2 Prüfungen an den Geräten	22
9 Stückprüfungen	25
9.1 Sichtprüfungen	25
9.2 Isolationsprüfung	26
10 Kennzeichnung	26
Anhang A (informativ) Grundsätzliche Anforderungen an den Verguss für „mD“-Betriebsmittel	27
Anhang B (normativ) Prüfmusterzuordnung	28
Anhang C (normativ) Prüfverfahren während der thermischen Zyklusprüfungen	29
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen	30

	Seite
Anhang ZZ (informativ) Zusammenhang mit grundlegenden Anforderungen von EG-Richtlinien	32
Bild 1 – Abstände zwischen der freien Oberfläche der Vergussmasse und Bauelementen oder Leitern	14
Bild 2 – Schematische Darstellung der Abstände zwischen der Wand und/oder der freien Oberfläche der Vergussmasse und den Bauteilen/Leitern	15
Bild 3 – Abstände zwischen der Gehäusewand oder der freien Oberfläche der Vergussmasse und den Bauelementen oder Leitern	16
Bild 4 – Mindestabstände für Multilayer-Leiterplatten	17
Bild A.1 – Grundsätzliche Anforderungen an den Verguss für „mD“-Betriebsmittel	27
Bild C.1 – Prüfverfahren während der thermischen Zyklusprüfungen	29
Referenztablelle	3
Tabelle 1 – Abstände durch die Vergussmasse	13
Tabelle 2 – Dicke der Vergussmasse zwischen der freien Oberfläche der Vergussmasse und den Bauelementen oder Leitern	14
Tabelle 3 – Dicke der Vergussmasse zwischen der Gehäusewand oder der freien Oberfläche der Vergussmasse und den Bauelementen oder Leitern	15
Tabelle 4 – Dicke der Vergussmasse zwischen der Gehäusewand oder der freien Oberfläche der Vergussmasse und den Bauelementen oder Leitern	16
Tabelle 5 – Mindestabstände bei Multilayer-Leiterplatten	17
Tabelle 6 – Zulässige Primärzellen	19
Tabelle 7 – Zulässige Sekundärzellen	19
Tabelle 8 – Druckprüfung	25
Tabelle B.1 – Prüfmusterzuordnung	28